

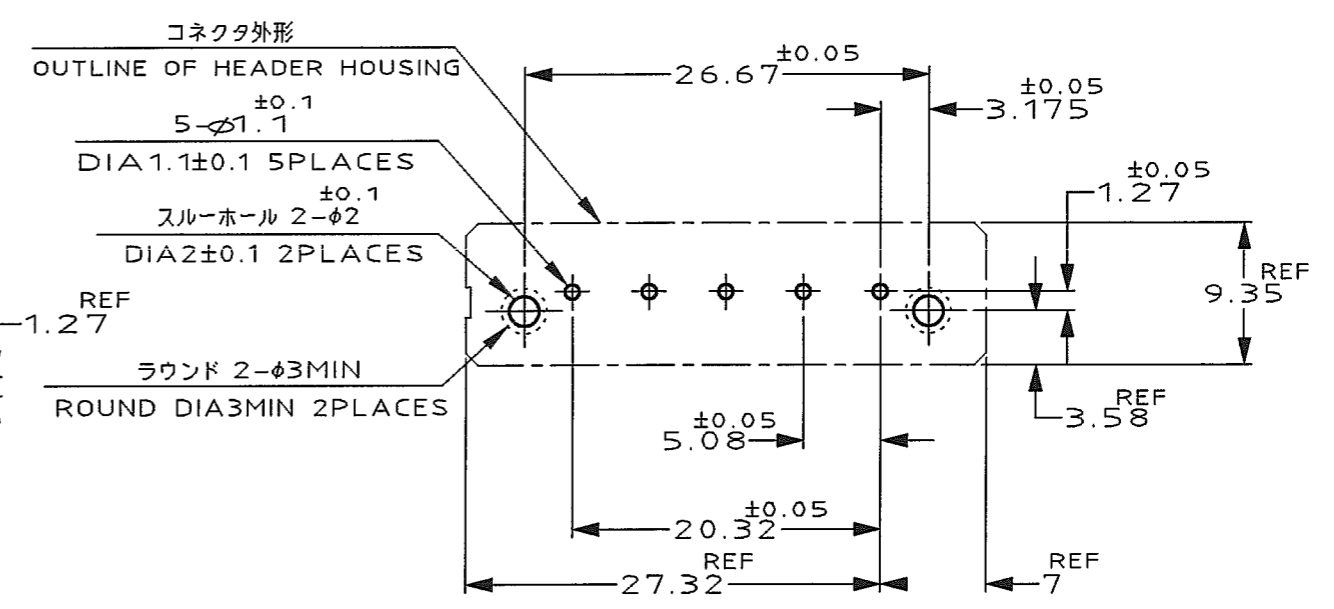
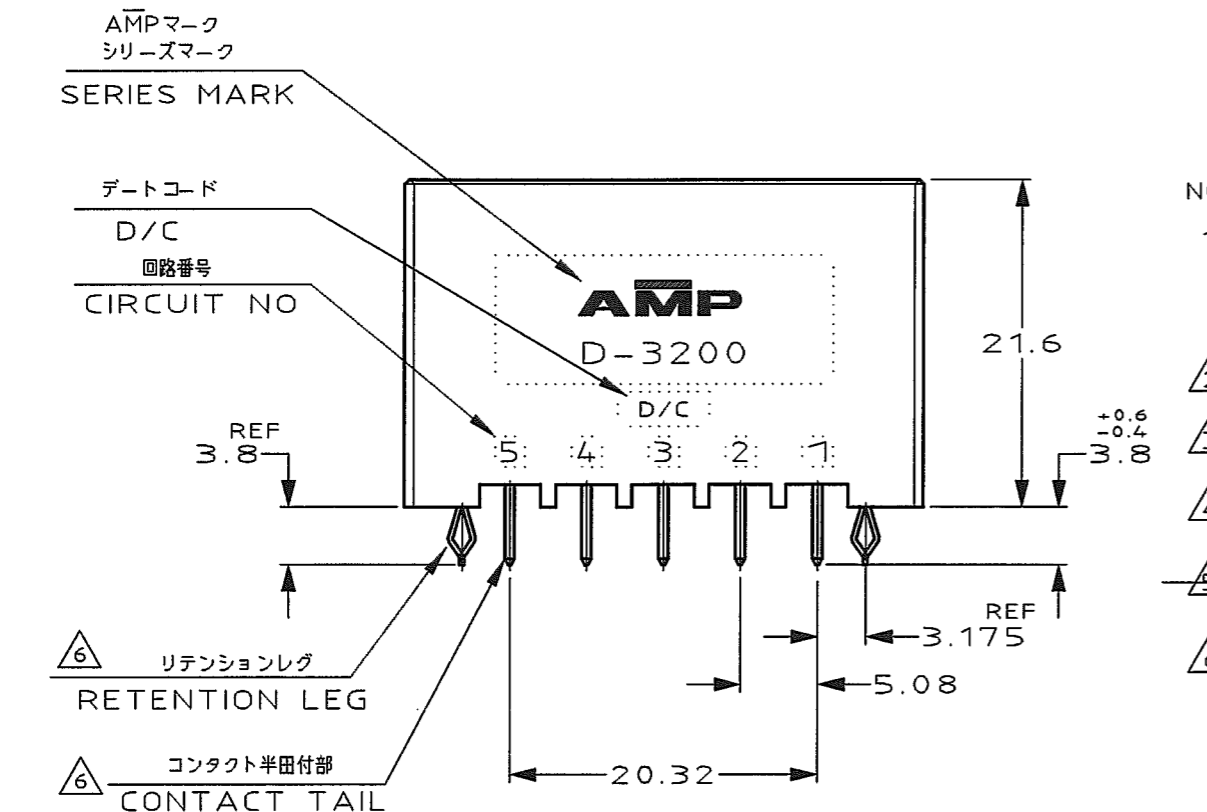
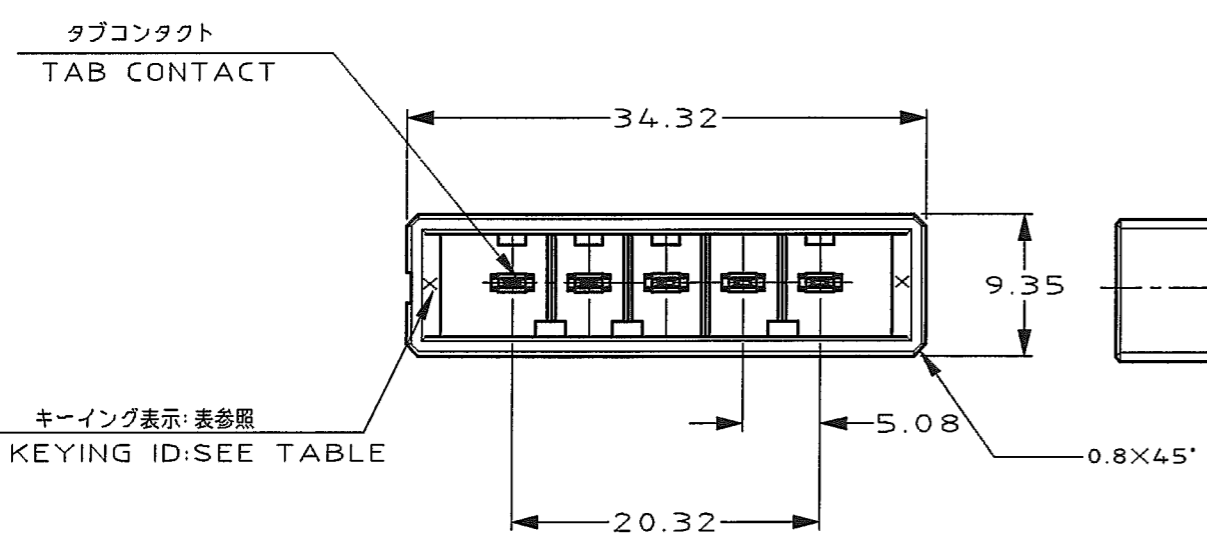
NUMBER 316132



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け寸法  
PC 基板厚: 1.6±0.1 (非累積公差) (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE) (CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER(94V-0), COLOR: BLACK  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒  
 contacts: 銅合金  
 リテンションレグ: 銅合金
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
 接触部: 0.38μm MIN金めっき
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
 接触部: 0.76μm MIN金めっき
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
  - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
 : ニッケル下地の上に半田めっき
  - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
 : ニッケル下地の上にスズめっき

	Y	△6 △4	2-316132-5
		△6 △3	2-316132-3
	X	△6 △2	2-316132-2
		△6 △4	1-316132-5
		△6 △3	1-316132-3
		△6 △2	1-316132-2

KEYING LOCATION				KEYING		FINISH		PART NO.		
Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.										
WIRE RANGE				INSULATION DIA		NAME				
mm²(AWG - )				mmφ		ダイナミック D-3200S 5.08 ピッチ (V) 5極 ヘッダーアセンブリー				
MATERIAL				FINISH		DYNAMIC D-3200S 5.08PITCH(V) 5 POS.HDR CONN.ASS'Y				
SEE NOTES 注記参照				SEE NOTES 注記参照						
DR. 26/JUL/'95				DE. 26/JUL/'95		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				
K.IKEDA				K.IKEDA		10% ±0.3				
CHK. 2/AUG/'95				APP. 2/AUG/'95		10% 30% ±0.4				
Y.ISHIKAWA				S.MANABE		30% 100% ±0.45				
LTR REVISION RECORD				DR CHK DATE		SCALE		REV.		SHEET
						2-1		B		1 OF 1

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-316132-3](#)